

HM270B产品手册 无编织增强粘结片

Product description 产品描述

- HM270B半固化片是一种不含编织玻璃纤维的热固性树脂与陶瓷粘结片，高频应用下插入损耗极低，适用于77GHz毫米波等对插入损耗敏感的应用场景，用于压合多层线路板或直接覆铜箔压合使用
- HM270B材料可以与PTFE、环氧树脂、PPO树脂、碳氢树脂和LCP等材料进行粘合。不高于210°C的热压合温度使得HM270B材料可以满足大多数多层线路板加工工艺，而经过热压固化后的材料Tg高达260°C以上

Areas of application 典型应用

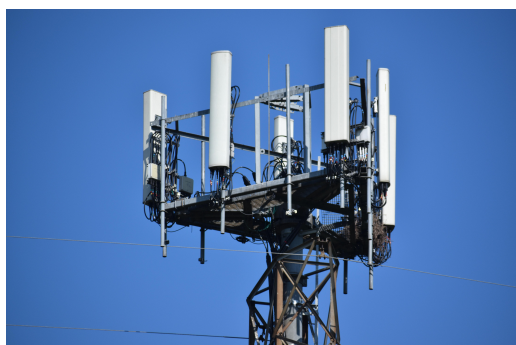
- 在毫米波等高频应用中作为多层板粘结片

Features and benefits 特性与优势

- 损耗极低
- 用于压合多层线路板

Standard size 标准尺寸

- 24" X 18" (610 X 457 mm)
- 24" X 20" (610 X 508 mm)



序号 No	性能 Property	测试方法 Test Method	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Value
1	厚度 Thickness	—	—	mil	4.4
2	介电常数 10 GHz Permittivity at 10 GHz	IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	2.70 ± 0.05
3	损耗角正切值 10 GHz Loss Tangent at 10 GHz	IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	0.0020
4	剥离强度 Peel Strength	IPC TM-650 2.4.8	1 oz. 电解铜箔, 热应力后	N/mm (lbs/in)	0.90 (5.1)
5	热膨胀系数CTE-Z轴 Coefficient of Thermal Expansion in the Z-Axis	IPC TM-650 2.4.41	0-150°C	ppm/°C	67
6	热导率 Thermal Conductivity	ASTM D5470	70°C	W/(m·K)	0.37
7	表面电阻率 Surface Resistivity	IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ	7.0×10 ¹⁰
8	体积电阻率 Volume Resistivity	IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ·cm	4.8×10 ¹⁰
9	吸水率 Moisture Absorption	IPC TM-650 2.5.6.1	D-48/50	%	0.07
10	拉伸强度 Tensile Strength	GB/T1040.4-2006	23°C	MPa	14
11	拉伸模量 Tensile Modulus	GB/T1040.4-2006	23°C	MPa	203
12	密度 Density	ASTM D792 Method A	23°C	g/cm ³	1.8
13	耐燃性 Flammability	UL94 Vertical Burn	—	—	非阻燃
14	无铅兼容性 Lead-Free Process Compatible	—	—	—	Yes

说明1：典型值表示通常厚度情况下的多次测量不同批次产品性能指标的平均数值。如果对参数有特殊需求或疑问，请联系湍流电子公司。

Remark1: Typical value represent an average value from a population of tested material and on the most common thickness. For any specific requirement or question, please contact Tuanliu Electric Co.